

インタビュー

(株)日本スペリア社
代表取締役社長

西村 哲郎 氏



— 西村 氏、おはようございます。

— さて、SnCu—Niベースの鉛フリーはんだ合金は黄金武器と
思っている。

— おり、もちろん日本のJIS、米国のIECにも登録されている。ちなみに当社が持つ知的財産所
スすることに
よって、知的
財産権を有効
活用してい
る。14年には、
世界標準規格
のISO規格
に登録されて

— 融点が220℃前後と低
いため、電子部品と電子
基板の接合に多く用いら
れている。また焼結型接
合材は、ナノサイズの銀
にアルコールを被膜させ
たペースト状の接合材で
あり、高い耐熱性と熱伝
導性を持つことが最大の
特徴だ。半導体やLED
素子には、今後多く用い
られていくだろう。

— 中国、香港、マレーシア、
シンガポール、タイ、ベ
トナム、インドネシア、
米国などで13拠点を持っ
ている。最近では、中国
の南通に新工場を立ち上
げた。また、マレーシア
でも新工場が立ち上がる
が、これは今や話題とな
っているパワーモジュー
ル向けのはんだ接合材の
生産を強化するものだ。

— 時ののはんだ付け工程での
加熱により、接合する部
品やプリント基板に過度
な反りが発生して接合不
良となることがある。こ
れを回避するためには、
実装温度を低くするしか
ない。そこでSn-Bi
はんだ合金による低温接
合に注目した。Bi系は
信頼性の低い合金ではあ
るが、弱点を克服するこ
とにより、は
んだ付け実装
にほぼめどが
ついた。エネ

— であろうし、低消費電力
のロジック、メモリーが
どうしても必要になる。
一方で、データセンター
の拡大で半導体が急増す
れば、世界の電力は全く
足りなくなる。きたるべ
き未来社会はエッジコン
ピューティング推進の一
方で、電力不足が大きな
懸念という二律背反の世
界になる。アドバンスド
パッケージングはここ数
年で1兆円という大型市
場になっていくと考えて
いるが、当社は総力を挙
げて、ローパワーに取り
組む開発をさらに加速し
ていく考えだ。ちなみに
70年の大阪万博は当社の
本社がある吹田で開催さ
れ、一大成功を収めた。
25年の大阪・関西万博も
ぜひとも成功してほしい
との想いで当社は積極的
にこの万博に協賛してい
る。

はんだ合金「SN100C」で地歩築く

海外工場強化し売上500億円へ

— いえますね。

— 西村 氏 そのとおりだ。

— SN100Cと名づけた
高信頼性銀レスの鉛フリ
ーはんだ合金は、世界24
カ国の特許を取得してお
り、またそれらの国々で
SN100Cおよび社名
ロゴを商標登録してい
る。自社が販売網を持た
ない地域においても、現
地のはんだメーカーの特
許権、商標権をライセンス

— 有権は276件もある。

— 貴社の金属接合材
のラインアップは。

— 西村 氏 まず伝統的なろ
う付接合材がある。銀、
銅、真鍮、アルミなどの
異なる金属を使ってろ
う付接合材を製造してい
る。次に、はんだ付接合
材があり、通電性が良く

— 現状の売上状況と
今後の拡大について。

— 西村 氏 売上高はグルー
プ全体で441億円とな
っているが、海外が70%、
国内が30%という比率
だ。今後は海外が大きく
拡大してくるとみてお
り、まずは500億円突
破が目標となる。台湾、

— 最近のエポックメ
ーキングな開発を教えて
下さい。

— 西村 氏 ここにきて、半
導体チップの複雑な構造
やレイアウト、配線の積
層化によってパッケージ
は大型化し、外部端子も
ますます小型多ピン化し
ている。そのため、実装

— ルギー削減にもなり、カ
ーボンニュートラルにも
貢献できる。

— SDGs、メタバ
ースの時代を迎えて貴社
の出番は増えますね。

— 西村 氏 確かに時代のキ
ーワードは圧倒的なロー
パワーにある。パワー半
導体は時代の主役になる

(株)日本スペリア社(大
阪府吹田市)は、196
6年に設立され、ルーツ
は「ろう材」の輸入・販
売であり、57年の歴史を
刻んできた。今日にあっ
て同社は「金属接合材で
世界をつなぎ合わせるカ
ンパニー」と位置づけら
れており、とりわけ鉛フ
リーはんだ合金「SN1
00C」の開発で地歩を
築き、国内外にその名を
知られている。今回、同
社を陣頭指揮で率いる代
表取締役社長の西村哲郎
氏に話を伺った。

— 数々の表彰歴をお
持ちですね。
西村 氏 関西大学工学部
マレーシアのペルリス大
学から名誉工学博士号を
授与された。これは嬉し
かった。10年には特許庁
から知財功労賞、大阪府
ものづくり優良企業賞の
最優秀企業賞、11年に吹
田市産業表彰と立て続け
に受賞した。最近では、
18年と22年に日本溶接協
会の注目発明賞を受賞し
ている。こうした評価は、
本当にありがたいことだ

— 西村 氏 そのとおりだ。
SN100Cと名づけた
高信頼性銀レスの鉛フリ
ーはんだ合金は、世界24
カ国の特許を取得してお
り、またそれらの国々で
SN100Cおよび社名
ロゴを商標登録してい
る。自社が販売網を持た
ない地域においても、現
地のはんだメーカーの特
許権、商標権をライセンス

— 有権は276件もある。
— 貴社の金属接合材
のラインアップは。
— 西村 氏 まず伝統的なろ
う付接合材がある。銀、
銅、真鍮、アルミなどの
異なる金属を使ってろ
う付接合材を製造してい
る。次に、はんだ付接合
材があり、通電性が良く

— 現状の売上状況と
今後の拡大について。
— 西村 氏 売上高はグルー
プ全体で441億円とな
っているが、海外が70%、
国内が30%という比率
だ。今後は海外が大きく
拡大してくるとみてお
り、まずは500億円突
破が目標となる。台湾、

— 最近のエポックメ
ーキングな開発を教えて
下さい。
— 西村 氏 ここにきて、半
導体チップの複雑な構造
やレイアウト、配線の積
層化によってパッケージ
は大型化し、外部端子も
ますます小型多ピン化し
ている。そのため、実装

— ルギー削減にもなり、カ
ーボンニュートラルにも
貢献できる。
— SDGs、メタバ
ースの時代を迎えて貴社
の出番は増えますね。
— 西村 氏 確かに時代のキ
ーワードは圧倒的なロー
パワーにある。パワー半
導体は時代の主役になる

— であろうし、低消費電力
のロジック、メモリーが
どうしても必要になる。
一方で、データセンター
の拡大で半導体が急増す
れば、世界の電力は全く
足りなくなる。きたるべ
き未来社会はエッジコン
ピューティング推進の一
方で、電力不足が大きな
懸念という二律背反の世
界になる。アドバンスド
パッケージングはここ数
年で1兆円という大型市
場になっていくと考えて
いるが、当社は総力を挙
げて、ローパワーに取り
組む開発をさらに加速し
ていく考えだ。ちなみに
70年の大阪万博は当社の
本社がある吹田で開催さ
れ、一大成功を収めた。
25年の大阪・関西万博も
ぜひとも成功してほしい
との想いで当社は積極的
にこの万博に協賛してい
る。
(聞き手・特別編集委員
泉谷渉)